



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Centro de Documentação e Informação

DECRETO Nº 6.233, DE 11 DE OUTUBRO DE 2007

(Revogado pelo Decreto nº 10.615, de 29/1/2021)

Estabelece critérios para efeito de habilitação ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores - PADIS, que concede isenção do imposto de renda e reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS e do IPI, instituído pelos arts. 1º a 11 da Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 1º a 11 da Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007,

DECRETA:

CAPÍTULO I
DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO DA INDÚSTRIA DE SEMICONDUCTORES - PADIS

Art. 1º O Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores - PADIS será aplicado na forma deste Decreto.

Art. 2º O PADIS reduz a zero as alíquotas:

I - da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda, no mercado interno, à pessoa jurídica habilitada no PADIS, de:

a) máquinas, aparelhos, instrumentos, equipamentos, para incorporação ao ativo imobilizado da adquirente, destinados às atividades de que trata o art. 6º; e *(Alínea com redação dada pelo Decreto nº 8.247, de 23/5/2014)*

b) ferramentas computacionais (*softwares*) e dos insumos das atividades de que trata o art. 6º; *(Alínea com redação dada pelo Decreto nº 8.247, de 23/5/2014)*

II - da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação, incidentes sobre a importação, realizada por pessoa jurídica habilitada no PADIS, de:

a) máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, para incorporação ao ativo imobilizado da importadora, destinados às atividades de que trata o art. 6º; e [\(Alínea com redação dada pelo Decreto nº 8.247, de 23/5/2014\)](#)

b) ferramentas computacionais (*softwares*) e dos insumos das atividades de que trata o art. 6º; [\(Alínea com redação dada pelo Decreto nº 8.247, de 23/5/2014\)](#)

III - do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, incidente na importação realizada por pessoa jurídica habilitada no PADIS, ou na saída do estabelecimento industrial ou equiparado em razão de aquisição efetuada no mercado interno por pessoa jurídica habilitada ao PADIS, de:

a) máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, para incorporação ao ativo imobilizado da importadora, destinados às atividades de que trata o art. 6º; e [\(Alínea com redação dada pelo Decreto nº 8.247, de 23/5/2014\)](#)

b) ferramentas computacionais (*softwares*) e dos insumos das atividades de que trata o art. 6º; e [\(Alínea com redação dada pelo Decreto nº 8.247, de 23/5/2014\)](#)

IV - do Imposto de Importação, incidente sobre insumos importados por pessoa jurídica beneficiária do PADIS e sobre máquinas, aparelhos, instrumentos, equipamentos, ferramentas computacionais (*software*), para incorporação ao seu ativo imobilizado, destinados às atividades mencionadas no art. 6º, nas condições e prazos definidos nos art. 13 e art. 23-A. [\(Inciso acrescido pelo Decreto nº 7.600, de 7/11/2011, e com redação dada pelo Decreto nº 8.247, de 23/5/2014\)](#)

Parágrafo único. Para efeitos deste artigo, equipara-se ao importador a pessoa jurídica adquirente de bens estrangeiros, no caso de importação realizada por sua conta e ordem por intermédio de pessoa jurídica importadora.

Art. 3º Fica reduzida a zero a alíquota da contribuição de intervenção no domínio econômico - CIDE destinada a financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação, de que trata o art. 2º da Lei nº 10.168, de 29 de dezembro de 2000, nas remessas destinadas ao exterior para pagamento de contratos relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de tecnologia e prestação de assistência técnica, quando efetuadas por pessoa jurídica beneficiária do PADIS e vinculadas às atividades de que trata o art. 6º. [\(“Caput” do artigo com redação dada pelo Decreto nº 8.247, de 23/5/2014\)](#)

Art. 4º Nas vendas dos dispositivos eletrônicos semicondutores, mostradores de informação (*displays*) e insumos e equipamentos dedicados e destinados à fabricação destes componentes, referidos no art. 6º, efetuadas por pessoa jurídica beneficiária do PADIS, ficam reduzidas: [\(“Caput” do artigo com redação dada pelo Decreto nº 8.247, de 23/5/2014\)](#)

I - a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre as receitas auferidas;

II - a zero as alíquotas do IPI incidentes sobre a saída do estabelecimento industrial; e

III - em cem por cento as alíquotas do imposto de renda e adicional incidentes sobre o lucro da exploração.

§ 1º As reduções de alíquotas previstas nos incisos I e III do *caput* deste artigo aplicam-se também às receitas decorrentes da venda de projeto (*design*), quando efetuada por pessoa jurídica habilitada ao PADIS.

§ 2º As reduções de alíquotas de que trata o *caput* deste artigo não se aplicam cumulativamente com outras reduções ou benefícios relativos aos mesmos impostos ou

contribuições, ressalvado o disposto no inciso I do *caput* e no § 2º do art. 17 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005.

CAPÍTULO II DA HABILITAÇÃO AO PADIS

Seção I Da Obrigatoriedade da Habilitação

Art. 5º Apenas a pessoa jurídica previamente habilitada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB é beneficiária do PADIS.

Seção II Das Pessoas Jurídicas que Podem Requerer a Habilitação

Art. 6º A habilitação de que trata o art. 5º somente pode ser requerida por pessoa jurídica que realize investimento em pesquisa e desenvolvimento - P&D, na forma do art. 8º, e que exerça isoladamente ou em conjunto, em relação a: [“Caput” do artigo com redação dada pelo Decreto nº 8.247, de 23/5/2014](#)

I - dispositivos eletrônicos semicondutores, classificados nas posições 85.41 e 85.42 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, relacionados no Anexo I, as atividades de: [Inciso com redação dada pelo Decreto nº 8.247, de 23/5/2014](#)

- a) concepção, desenvolvimento e projeto (*design*);
- b) difusão ou processamento físico-químico; ou
- c) corte, encapsulamento e teste; [Alínea com redação dada pelo Decreto nº 8.247, de 23/5/2014](#)

II - mostradores de informação (*displays*) de que trata o § 1º deste artigo, as atividades de:

- a) concepção, desenvolvimento e projeto (*design*);
- b) fabricação dos elementos fotossensíveis, foto ou eletroluminescentes e emissores de luz; ou
- c) montagem final do mostrador e testes elétricos e ópticos; ou [Alínea com redação dada pelo Decreto nº 8.247, de 23/5/2014](#)

III - insumos e equipamentos dedicados e destinados à industrialização dos produtos descritos nos incisos I e II do *caput*, a atividade de fabricação conforme Processo Produtivo Básico estabelecido pelos Ministérios do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da Ciência, Tecnologia e Inovação. [Inciso acrescido pelo Decreto nº 8.247, de 23/5/2014](#)

§ 1º O disposto no inciso II do *caput* deste artigo:

I - alcança somente os mostradores de informações (*displays*), relacionados no Anexo I deste Decreto, com tecnologia baseada em componentes de cristal líquido (LCD), fotoluminescentes (painel mostrador de plasma - PDP), eletroluminescentes (diodos emissores de luz - LED, diodos emissores de luz orgânicos - OLED ou *displays* eletroluminescentes a filme fino - TFEL) ou similares com microestruturas de emissão de campo elétrico, destinados à utilização como insumo em equipamentos eletrônicos; e

II - não alcança os tubos de raios catódicos (CRT).

§ 2º Para efeitos deste artigo, considera-se que a pessoa jurídica exerce as atividades:

I - isoladamente, quando executar todas as etapas previstas na alínea dos incisos do *caput* em que se enquadrar; ou

II - em conjunto, quando executar todas as atividades previstas no inciso do *caput* em que se enquadrar.

§ 3º A pessoa jurídica de que trata o *caput* deve exercer, exclusivamente, as atividades previstas neste artigo.

§ 4º O investimento em pesquisa e desenvolvimento referido no *caput* e o exercício das atividades de que trata este artigo devem ser efetuados de acordo com projetos aprovados na forma do art. 7º. [\(Parágrafo com redação dada pelo Decreto nº 8.247, de 23/5/2014\)](#)

§ 5º O disposto no inciso I do *caput* alcança os dispositivos eletrônicos semicondutores, montados e encapsulados diretamente sob placa de circuito impresso - chip on board, classificados no código 8523.51 da NCM. [\(Parágrafo com redação dada pelo Decreto nº 8.247, de 23/5/2014\)](#)

§ 5º O disposto no inciso I do *caput* alcança os dispositivos eletrônicos semicondutores das posições 85.41 e 85.42 da NCM, montados e encapsulados mediante o processo *chip on board* diretamente sob placa de circuito impresso classificada no código 8534.00.00 da NCM, desde que resulte em produto classificado na posição 85.42 ou na subposição 8523.51 da NCM. [\(Parágrafo acrescido pelo Decreto nº 7.600, de 7/11/2011\)](#)

§ 6º Para efeitos deste Decreto, a operação de montagem e encapsulamento de *chip on board* de que trata o § 5º fica enquadrada na atividade de encapsulamento referida na alínea "c" do inciso I do *caput*. [\(Parágrafo acrescido pelo Decreto nº 7.600, de 7/11/2011\)](#)

§ 7º A etapa de corte, prevista na alínea "c" do inciso I do *caput*, será exigida após o prazo de doze meses, contado da publicação deste Decreto. [\(Parágrafo acrescido pelo Decreto nº 8.247, de 23/5/2014\)](#)

Seção III

Da Aprovação dos Projetos

Art. 7º Os projetos referidos no § 4º do art. 6º deverão ser aprovados em portaria conjunta dos Ministros de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. [\(“Caput” do artigo com redação dada pelo Decreto nº 8.247, de 23/5/2014\)](#)

§ 1º A aprovação de projeto de que trata o *caput* fica condicionada a:

I - comprovação de regularidade fiscal, da pessoa jurídica interessada, em relação aos tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

II - observância das instruções fixadas em portaria conjunta dos Ministros de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; e [\(Inciso com redação dada pelo Decreto nº 8.247, de 23/5/2014\)](#)

III - verificação prévia pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos e condições a serem estabelecidos em ato próprio, do enquadramento aos Anexos deste Decreto dos bens apresentados pela pessoa jurídica habilitada.

§ 2º Os projetos poderão ser apresentados até 31 de maio de 2015. [\(Parágrafo com redação dada pelo Decreto nº 8.247, de 23/5/2014\)](#)

§ 3º Os procedimentos para apreciação dos projetos serão estabelecidos mediante portaria conjunta dos Ministros de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. [\(Parágrafo com redação dada pelo Decreto nº 8.247, de 23/5/2014\)](#)

§ 4º A portaria conjunta de que trata o *caput* estabelecerá os critérios insumo-produto ou insumo-capacidade de produção, de forma a adequar as aquisições de bens constantes do Anexo a este Decreto à capacidade de utilização pela pessoa jurídica habilitada nas atividades referidas no art. 6º.

Seção IV

Do Investimento em Pesquisa e Desenvolvimento

Art. 8º A pessoa jurídica beneficiária do PADIS deverá investir, anualmente, em atividades de pesquisa e desenvolvimento a serem realizadas no País, no mínimo cinco por cento do seu faturamento bruto no mercado interno, deduzidos os impostos incidentes na comercialização dos dispositivos, insumos e equipamentos de que trata o art. 6º e o valor das aquisições de produtos incentivados abrangidos pelo PADIS. ([“Caput” do artigo com redação dada pelo Decreto nº 8.247, de 23/5/2014](#))

§ 1º Serão admitidos apenas investimentos nas áreas de microeletrônica em atividades de pesquisa e desenvolvimento dos dispositivos mencionados nos incisos I e II do *caput* do art. 6º, de optoeletrônicos, de ferramentas computacionais (*softwares*), de suporte a tais projetos e de metodologias de projeto e de processo de fabricação dos componentes mencionados nos incisos I e II do *caput* do art. 6º.

§ 2º No mínimo um por cento do faturamento bruto, deduzidos os impostos incidentes na comercialização, na forma do *caput*, deverá ser aplicado mediante convênio com centros ou institutos de pesquisa ou entidades brasileiras de ensino, oficiais ou reconhecidas, credenciados pelo Comitê da Área de Tecnologia da Informação - CATI, de que trata o art. 30 do Decreto nº 5.906, de 26 de setembro de 2006, ou pelo Comitê das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento na Amazônia - CAPDA, de que trata o art. 26 do Decreto nº 6.008, de 29 de dezembro de 2006.

§ 3º A propriedade intelectual resultante da pesquisa e desenvolvimento realizados mediante os projetos aprovados no âmbito do PADIS deve ter a proteção requerida no território nacional junto ao órgão competente, conforme o caso, pela pessoa jurídica brasileira beneficiária do PADIS.

§ 4º Serão considerados como aplicação em pesquisa e desenvolvimento do ano-calendário, para os efeitos deste Decreto, eventuais pagamentos antecipados a terceiros para a execução de atividades de pesquisa e desenvolvimento de que trata o § 1º, desde que seus valores não sejam superiores a vinte por cento da correspondente obrigação do ano-calendário. ([Parágrafo acrescido pelo Decreto nº 7.600, de 7/11/2011](#))

§ 5º Para as pessoas jurídicas beneficiárias do PADIS, referidas no art. 6º, e exclusivamente sobre o faturamento bruto decorrente da comercialização dos dispositivos, insumos e equipamentos de que trata o art. 6º no mercado interno, o percentual para investimento em pesquisa e desenvolvimento estabelecido neste artigo fica reduzido:

I - de cinco por cento para três por cento, de 1º de janeiro de 2014 até 31 de dezembro de 2015; e

II - de cinco por cento para quatro por cento, de 1º de janeiro de 2016 até 31 de dezembro de 2018. ([Parágrafo acrescido pelo Decreto nº 8.247, de 23/5/2014](#))

§ 6º Fica restabelecido em cinco por cento o percentual de que trata o *caput*, de 1º de janeiro de 2019 até o termo final de fruição das reduções de que tratam os arts. 2º a 4º. ([Parágrafo acrescido pelo Decreto nº 8.247, de 23/5/2014](#))

Art. 9º A pessoa jurídica beneficiária do PADIS deverá encaminhar ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, até 31 de julho de cada ano, os relatórios demonstrativos do cumprimento, no ano-calendário anterior, das obrigações estabelecidas neste Decreto.

§ 1º Os relatórios demonstrativos de que trata o *caput* deverão ser elaborados em conformidade com as instruções fornecidas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

§ 2º Na elaboração dos relatórios referidos no § 1º será admitida a utilização de relatório simplificado, no qual a empresa poderá, em substituição à demonstração dos dispêndios previstos nos incisos de IV a X do *caput* do art. 10-B, indicar os seguintes percentuais aplicados sobre a totalidade dos demais dispêndios efetuados nas atividades de pesquisa e desenvolvimento em tecnologias da informação:

I - trinta por cento quando se tratar de projetos executados em convênio com instituições de ensino e pesquisa credenciadas pelo CATI e pelo CAPDA; e

II - vinte por cento, nos demais casos.

§ 3º A opção pelo relatório simplificado prevista no § 2º substitui a demonstração quanto aos dispêndios de mesma natureza da totalidade dos projetos do ano-base.

§ 4º Os percentuais previstos no § 2º poderão ser alterados mediante Portaria do Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação.

§ 5º Os relatórios demonstrativos serão apreciados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que comunicará os resultados da sua análise técnica às respectivas empresas e à Secretaria da Receita Federal do Brasil.

§ 6º Os procedimentos e prazos para análise dos relatórios demonstrativos serão definidos por Portaria do Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação. ([Artigo com redação dada pelo Decreto nº 7.600, de 7/11/2011](#))

Art. 10. No caso de os investimentos em pesquisa e desenvolvimento previstos no art. 8º não atingirem, em um determinado ano-calendário, o percentual mínimo fixado, a pessoa jurídica beneficiária do PADIS deverá aplicar o valor residual no Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT (CT-INFO ou CT-Amazônia), acrescido de multa de vinte por cento e de juros equivalentes à taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, calculados desde 1º de janeiro do ano subsequente àquele em que não foi atingido o percentual até a data da efetiva aplicação.

§ 1º A pessoa jurídica beneficiária do PADIS deverá efetuar a aplicação referida no *caput* deste artigo até o último dia útil do mês de março do ano subsequente àquele em que não foi atingido o percentual.

§ 2º Na hipótese do *caput* deste artigo, a não-realização da aplicação ali referida, no prazo previsto no § 1º, obriga o contribuinte ao pagamento:

I - de juros e multa de mora, na forma da lei, referentes às contribuições e ao imposto não pagos em decorrência das disposições dos incisos I e II do art. 4º; e

II - do imposto de renda e dos adicionais não pagos em função do disposto no inciso III do art. 4º, acrescido de juros e multa de mora, na forma da lei.

§ 3º Os juros e multa de que trata o inciso I do § 2º deste artigo serão recolhidos isoladamente e devem ser calculados:

I - a partir da data da efetivação da venda, no caso do inciso I do art. 4º, ou a partir da data da saída do produto do estabelecimentos industrial, no caso do inciso II do art. 4º; e

II - sobre o valor das contribuições e do imposto não recolhidos, proporcionalmente à diferença entre o percentual mínimo de aplicações em pesquisa e desenvolvimento fixado e o efetivamente efetuado.

§ 4º Os pagamentos efetuados na forma dos §§ 2º e 3º não desobrigam a pessoa jurídica beneficiária do PADIS do dever de efetuar a aplicação no FNDCT (CT-INFO ou CT-Amazônia), na forma do *caput*, acrescida da multa e dos juros ali referidos.

§ 5º A falta ou irregularidade do recolhimento previsto no § 2º sujeita a pessoa jurídica a lançamento de ofício, com aplicação de multa de ofício na forma da lei.

§ 6º O descumprimento das disposições deste artigo sujeita a pessoa jurídica às disposições do art. 11.

§ 7º Sem prejuízo do disposto nos §§ 2º a 6º, quando o valor residual decorrer de glosa de dispêndios em pesquisa e desenvolvimento, a empresa deverá efetuar o respectivo recolhimento ao FNDCT, conforme previsto no *caput*, até noventa dias após a comunicação do débito pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. ([Parágrafo acrescido pelo Decreto nº 8.247, de 23/5/2014](#))

§ 8º O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação estabelecerá em portaria as demais instruções para o recolhimento do valor residual a ser depositado no FNDCT. ([Parágrafo acrescido pelo Decreto nº 8.247, de 23/5/2014](#))

Art. 10-A. Consideram-se atividades de pesquisa e desenvolvimento nas áreas de microeletrônica, dos dispositivos semicondutores e mostradores da informação - *displays* - mencionados nos incisos I e II do *caput* do art. 2º da Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007, de optoeletrônicos, de ferramentas computacionais - *software* - de suporte a projetos e de metodologias de projeto e de processo de fabricação destes dispositivos, referidos no § 4º do art. 2º da Lei nº 11.484, de 2007, para fins do disposto no art. 6º da Lei nº 11.484, de 2007:

I - trabalho teórico ou experimental realizado de forma sistemática para adquirir novos conhecimentos, que vise atingir objetivo específico, descobrir novas aplicações ou obter ampla e precisa compreensão dos fundamentos subjacentes aos fenômenos e fatos observados, sem prévia definição para o aproveitamento prático dos resultados;

II - trabalho sistemático que utilize o conhecimento adquirido na pesquisa ou experiência prática para desenvolver novos materiais, produtos, dispositivos ou programas de computador, para implementar novos processos, sistemas ou serviços ou, então, para aperfeiçoar os já produzidos ou implantados, incorporando características inovadoras;

III - serviço científico e tecnológico de assessoria, consultoria, estudos, ensaios, metrologia, normalização, gestão tecnológica, fomento à invenção e inovação, transferência de tecnologia, gestão e controle da propriedade intelectual gerada dentro das atividades de pesquisa e desenvolvimento, desde que associado a quaisquer das atividades previstas nos incisos I e II do *caput*; e

IV - formação ou capacitação profissional de níveis médio e superior:

a) para aperfeiçoamento e desenvolvimento de recursos humanos em tecnologias de microeletrônica, mostradores da informação e tecnologias correlatas;

b) para aperfeiçoamento e desenvolvimento de recursos humanos envolvidos nas atividades de que tratam os incisos de I a III do *caput*; e

c) em cursos de formação profissional e de pós-graduação, observado o disposto no inciso III do *caput* do art. 27 do Decreto nº 5.906, de 2006.

§ 1º Será admitido o intercâmbio científico e tecnológico, internacional e inter-regional, como atividade complementar à execução de projeto de pesquisa e desenvolvimento, para fins do disposto no art. 6º da Lei nº 11.484, de 2007.

§ 2º As atividades de pesquisa e desenvolvimento da pessoa jurídica beneficiária do PADIS serão avaliadas por intermédio de indicadores de resultados, tais como:

- I - patentes depositadas no Brasil e no exterior;
 - II - concessão de cotitularidade ou de participação nos resultados da pesquisa e desenvolvimento, às instituições convenientes;
 - III - protótipos, processos, programas de computador e produtos que incorporem inovação científica ou tecnológica;
 - IV - publicações científicas e tecnológicas em periódicos ou eventos científicos com revisão pelos pares;
 - V - dissertações e teses defendidas;
 - VI - profissionais formados ou capacitados; e
 - VII - melhoria das condições de emprego e renda e promoção da inclusão social.
- (Artigo acrescido pelo Decreto nº 7.600, de 7/11/2011)

Art. 10-B. Serão enquadrados como dispêndios de pesquisa e desenvolvimento, para fins das obrigações previstas no art. 6º da Lei nº 11.484, de 2007, os gastos realizados na execução ou contratação das atividades especificadas no art. 10-A, desde que se refiram, sem prejuízo de outros correlatos, a: (“Caput” do artigo acrescido pelo Decreto nº 7.600, de 7/11/2011)

I - uso de programas de computador, máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, seus acessórios, sobressalentes e ferramentas, assim como serviço de instalação dessas máquinas e equipamentos; (Inciso acrescido pelo Decreto nº 7.600, de 7/11/2011)

II - implantação, ampliação ou modernização de laboratórios de pesquisa e desenvolvimento; (Inciso acrescido pelo Decreto nº 7.600, de 7/11/2011)

III - modernização do processo de produção; (Inciso acrescido pelo Decreto nº 7.600, de 7/11/2011)

IV - recursos humanos diretos; (Inciso acrescido pelo Decreto nº 7.600, de 7/11/2011)

V - recursos humanos indiretos; (Inciso acrescido pelo Decreto nº 7.600, de 7/11/2011)

VI - aquisições de livros e periódicos técnicos; (Inciso acrescido pelo Decreto nº 7.600, de 7/11/2011)

VII - materiais de consumo; (Inciso acrescido pelo Decreto nº 7.600, de 7/11/2011)

VIII - viagens; (Inciso acrescido pelo Decreto nº 7.600, de 7/11/2011)

IX - treinamento; e (Inciso acrescido pelo Decreto nº 7.600, de 7/11/2011)

X - serviços técnicos de terceiros. (Inciso acrescido pelo Decreto nº 7.600, de 7/11/2011)

§ 1º Excetuados os serviços de instalação, para efeito das aplicações previstas no § 6º, os gastos de que trata o inciso I do *caput* deverão ser computados pelos valores da depreciação, da amortização, do aluguel ou da cessão de direito de uso desses recursos, correspondentes ao período da sua utilização na execução das atividades de pesquisa e desenvolvimento. (Parágrafo acrescido pelo Decreto nº 7.600, de 7/11/2011)

§ 2º A cessão de recursos materiais definitiva, ou por pelo menos cinco anos, a instituições de ensino e pesquisa credenciadas pelo CATI ou pelo CAPDA, necessária à realização de atividades de pesquisa e desenvolvimento, será computada para a apuração do montante dos gastos:

I - pelos seus valores de custo de produção ou aquisição, deduzida a respectiva depreciação acumulada; ou

II - por cinquenta por cento do valor de mercado, mediante laudo de avaliação. [\(Parágrafo acrescido pelo Decreto nº 7.600, de 7/11/2011\)](#)

§ 3º Os convênios referidos no § 2º do art. 8º deverão contemplar até vinte por cento do montante a ser gasto em cada projeto, para fins de ressarcimento de custos incorridos pelas instituições de ensino e pesquisa credenciadas pelo CATI ou pelo CAPDA, e para constituição de reserva a ser por elas utilizada em pesquisa e desenvolvimento do setor de tecnologias da informação. [\(Parágrafo acrescido pelo Decreto nº 7.600, de 7/11/2011\)](#)

§ 4º Para efeito das aplicações previstas no § 2º do art. 8º, poderão ser computados os valores integrais relativos aos dispêndios de que tratam os incisos I a III do *caput*, mantendo-se o compromisso da instituição na utilização dos bens assim adquiridos em atividades de pesquisa e desenvolvimento até o final do período de depreciação. [\(Parágrafo acrescido pelo Decreto nº 7.600, de 7/11/2011\)](#)

§ 5º As empresas e as instituições de ensino e pesquisa envolvidas na execução de atividades de pesquisa e desenvolvimento, em cumprimento ao disposto no art. 8º, deverão efetuar escrituração contábil específica das operações relativas a tais atividades. [\(Parágrafo acrescido pelo Decreto nº 7.600, de 7/11/2011\)](#)

§ 6º A documentação técnica e contábil relativa às atividades de que trata o § 5º deverá ser mantida pelo prazo mínimo de cinco anos, a contar da data da entrega dos relatórios de que trata o art. 9º. [\(Parágrafo acrescido pelo Decreto nº 7.600, de 7/11/2011\)](#)

§ 7º Os gastos realizados na execução ou contratação das atividades referidas no inciso III do *caput* não poderão ser superiores a trinta por cento do total de dispêndios em pesquisa e desenvolvimento, no ano-calendário. [\(Parágrafo acrescido pelo Decreto nº 8.247, de 23/5/2014\)](#)

Art. 10-C. No caso de produção terceirizada contratada com pessoa jurídica beneficiária do PADIS, a empresa contratante poderá assumir as obrigações previstas no art. 8º, correspondentes ao faturamento decorrente da comercialização de dispositivos semicondutores ou mostradores de informação – *displays* - beneficiados pelo PADIS, obtido pela contratada beneficiária do PADIS com a contratante, observadas as seguintes condições:

I - o repasse das obrigações relativas às aplicações em pesquisa e desenvolvimento à contratante, pela contratada beneficiária do PADIS, não exime a contratada da responsabilidade pelo seu cumprimento e das obrigações previstas nos arts. 9º e 10;

II - a contratada beneficiária do PADIS fica sujeita às penalidades previstas no art. 11, no caso de descumprimento das obrigações;

III - o repasse das obrigações poderá ser integral ou parcial;

IV - ao assumir as obrigações das aplicações em pesquisa e desenvolvimento da contratada beneficiária do PADIS, fica a empresa contratante com a responsabilidade de submeter ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação o seu Plano de Pesquisa e Desenvolvimento em Microeletrônica ou *displays*, nos termos previstos nos arts. 6º e 8º, e de apresentar os correspondentes relatórios demonstrativos do cumprimento das obrigações assumidas; e

V - caso seja descumprido o disposto no inciso IV do *caput*, não será reconhecido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação o repasse das obrigações acordado entre as empresas, subsistindo a responsabilidade da contratada beneficiária do PADIS pelas obrigações assumidas em decorrência da fruição dos benefícios do PADIS. [\(Artigo acrescido pelo Decreto nº 7.600, de 7/11/2011\)](#)

Art. 10-D. Para fins do disposto no § 2º do art. 6º da Lei nº 11.484, de 2007, e no § 2º do art. 8º, considera-se como centro ou instituto de pesquisa ou entidade brasileira de ensino, oficial ou reconhecida:

I - os centros ou institutos de pesquisa mantidos por órgãos e entidades da administração pública, direta e indireta, as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público e as demais organizações sob o controle direto ou indireto da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que exerçam atividades de pesquisa e desenvolvimento em tecnologias da informação e comunicação e nas áreas relacionadas no § 1º do art. 8º; [\(Inciso com redação dada pelo Decreto nº 8.247, de 23/5/2014\)](#)

II - os centros ou institutos de pesquisa, as fundações e as demais organizações de direito privado que exerçam atividades de pesquisa e desenvolvimento em tecnologias da informação e comunicação e nas áreas relacionadas no § 1º do art. 8º, e que preencham os seguintes requisitos: [\(“Caput” do inciso com redação dada pelo Decreto nº 8.247, de 23/5/2014\)](#)

a) não distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a título de lucro ou de participação no resultado, por qualquer forma, aos seus dirigentes, sócios ou mantenedores;

b) aplicar seus recursos na implementação de projetos no País, visando à manutenção de seus objetivos institucionais; e

c) destinar o seu patrimônio, em caso de dissolução, a entidade congênere, do País, que satisfaça os requisitos previstos neste artigo; e

III - as entidades brasileiras de ensino que atendam ao disposto nos incisos I e II do *caput* do art. 213 da Constituição, ou sejam mantidas pelo Poder Público conforme definido no inciso I do *caput*, com cursos nas áreas de tecnologias da informação e de microeletrônica, como informática, computação, engenharias elétrica, eletrônica, mecatrônica, telecomunicações, física, química e outras ciências correlatas, reconhecidos pelo Ministério da Educação. [\(Artigo acrescido pelo Decreto nº 7.600, de 7/11/2011\)](#)

Art. 10-E. Para fiscalização do cumprimento das obrigações previstas neste Decreto, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação poderá solicitar a realização de inspeções e auditorias nas empresas e instituições de ensino e pesquisa, podendo, ainda, requerer, a qualquer tempo, a apresentação de informações sobre as atividades realizadas. [\(Artigo acrescido pelo Decreto nº 7.600, de 7/11/2011\)](#)

Art. 10-F. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, ouvidos os Ministérios afetos à matéria a ser disciplinada, poderá deliberar e expedir instruções complementares à execução deste Decreto. [\(Artigo acrescido pelo Decreto nº 7.600, de 7/11/2011\)](#)

Art. 10-G. Os resultados das atividades de pesquisa e desenvolvimento poderão ser divulgados, desde que mediante autorização prévia das entidades envolvidas. [\(Artigo acrescido pelo Decreto nº 7.600, de 7/11/2011\)](#)

CAPÍTULO III

DA SUSPENSÃO E DO CANCELAMENTO DA HABILITAÇÃO AO PADIS

Art. 11. A pessoa jurídica beneficiária do PADIS será punida, a qualquer tempo, com a suspensão da aplicação dos arts. 2º a 4º, sem prejuízo da aplicação de penalidades específicas, no caso das seguintes infrações:

I - não-apresentação ou não-aprovação dos relatórios de que trata o art. 9º;

II - descumprimento da obrigação de efetuar investimentos em pesquisa e desenvolvimento, na forma do art. 8º, observadas as disposições do art. 10;

III - descumprimento da obrigação de que trata o § 3º do art. 8º;

IV - irregularidade em relação a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; e

V - utilização diversa dos bens constantes dos Anexos deste Decreto em relação às atividades descritas no art. 6º, segundo critérios insumo-produto ou insumo-capacidade de produção estabelecidos no § 4º do art. 7º.

§ 1º A suspensão de que trata o *caput* converter-se-á em cancelamento da aplicação dos arts. 2º a 4º, no caso de a pessoa jurídica beneficiária do PADIS não sanar a infração no prazo de noventa dias contados da notificação da suspensão.

§ 2º A pessoa jurídica que der causa a duas suspensões em prazo inferior a dois anos-calendário será punida com o cancelamento da aplicação dos arts. 2º a 4º.

§ 3º A penalidade de cancelamento da aplicação somente poderá ser revertida após dois anos-calendário contados da data em que for sanada a infração que a motivou.

Art. 12. A suspensão e o cancelamento serão formalizados em ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

CAPÍTULO IV DA APLICAÇÃO DO PADIS

Art. 13. O benefício de redução das alíquotas de que tratam os incisos I a III do *caput* do art. 2º alcança somente as importações e as aquisições, no mercado interno, de: ([“Caput” do artigo com redação dada pelo Decreto nº 7.600, de 7/11/2011](#))

I - máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, relacionados no Anexo II deste Decreto; ([Inciso com redação dada pelo Decreto nº 6.887, de 25/6/2009, produzindo efeitos a partir de 18/9/2008](#))

II - insumos relacionados no Anexo III deste Decreto; e

III - ferramentas computacionais (*softwares*) relacionados no Anexo IV deste Decreto.

§ 1º O benefício de redução da alíquota do Imposto de Importação previsto no inciso IV do *caput* do art. 2º: ([“Caput” do parágrafo acrescido pelo Decreto nº 7.600, de 7/11/2011, com redação dada pelo Decreto nº 8.247, de 23/5/2014](#))

I - alcança as importações de máquinas, aparelhos, instrumentos, equipamentos e ferramentas computacionais (*softwares*), para incorporação ao seu ativo imobilizado, e insumos relacionados nos Anexos II a IV, realizadas por empresas habilitadas no PADIS; e ([Inciso acrescido pelo Decreto nº 8.247, de 23/5/2014](#))

II - será usufruído independentemente de exame de similaridade quanto aos produtos importados e de cumprimento da exigência de transporte em navio de bandeira brasileira. ([Inciso acrescido pelo Decreto nº 8.247, de 23/5/2014](#))

§ 2º ([Parágrafo acrescido pelo Decreto nº 7.600, de 7/11/2011 e revogado pelo Decreto nº 8.247, de 23/5/2014](#))

§ 3º As empresas habilitadas no PADIS deverão apresentar aos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior relação dos itens importados no ano-calendário anterior com o benefício de que trata o *caput*. [\(Parágrafo acrescido pelo Decreto nº 8.247, de 23/5/2014\)](#)

Art. 14. No caso de aquisição de bens no mercado interno com o benefício do PADIS, a pessoa jurídica vendedora deve fazer constar da nota fiscal de venda a expressão "Venda a pessoa jurídica habilitada no PADIS, efetuada com redução a zero de alíquota da Contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS e do IPI", com especificação do dispositivo legal correspondente, bem como o número do ato que concedeu a habilitação ao adquirente.

Art. 15. As reduções de alíquotas previstas nos incisos I e II do art. 4º, relativamente às vendas dos mostradores de informação (*displays*), referidos no inciso II do *caput* do art. 6º, aplicam-se somente quando:

I - a concepção, o desenvolvimento e o projeto (*design*) tenham sido desenvolvidos no País; ou

II - a fabricação dos elementos fotossensíveis, foto ou eletroluminescentes e dos emissores de luz tenha sido realizada no País.

Art. 16. O valor do imposto de renda e adicional que deixar de ser pago em virtude da redução de que trata o inciso III do art. 4º não poderá ser distribuído aos sócios e constituirá reserva de capital da pessoa jurídica, que somente poderá ser utilizada para absorção de prejuízos ou aumento do capital social.

Parágrafo único. Considera-se distribuição do valor do imposto:

I - a restituição de capital aos sócios, em caso de redução do capital social, até o montante do aumento com a incorporação da reserva de capital; e

II - a partilha do acervo líquido da sociedade dissolvida, até o valor do saldo da reserva de capital.

Art. 17. Para usufruir da redução de alíquotas de que trata o inciso III do art. 4º, a pessoa jurídica deverá demonstrar em sua contabilidade, com clareza e exatidão, os elementos que compõem as receitas, custos, despesas e resultados do período de apuração, referentes às vendas sobre as quais recaia a redução, segregados das demais atividades.

Art. 18. A inobservância do disposto nos arts. 16 e 17 importa perda do direito à redução de alíquotas de que trata o inciso III do art. 4º e obrigação de recolher, com relação à importância distribuída, o imposto que a pessoa jurídica tiver deixado de pagar, acrescido de juros e multa de mora, na forma da lei.

CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 19. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação deverá comunicar à Secretaria da Receita Federal do Brasil os casos de: [\(“Caput” do artigo com redação dada pelo Decreto nº 8.247, de 23/5/2014\)](#)

I - descumprimento, pela pessoa jurídica beneficiária do PADIS, da obrigação de encaminhar os relatórios demonstrativos, no prazo do art. 9º, ou da obrigação de aplicar no FNDCT (CT-INFO ou CT-Amazônia), na forma do *caput* do art. 10, observado o prazo do seu §

1º, quando não for alcançado o percentual mínimo de investimento em pesquisa e desenvolvimento;

II - não-aprovação dos relatórios demonstrativos de que trata o art. 9º; e

III - infringência a dispositivo deste Decreto.

Parágrafo único. Os casos previstos no inciso I devem ser comunicados até 30 de agosto de cada ano e, os demais casos, até trinta dias após a apuração da ocorrência.

Art. 20. Os Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulgarão, a cada três anos-calendário, relatórios com os resultados econômicos e tecnológicos advindos da aplicação das disposições deste Decreto. ([“Caput” do artigo com redação dada pelo Decreto nº 8.247, de 23/5/2014](#))

Parágrafo único. Os Ministérios referidos no *caput* procederão à divulgação, também, das modalidades e dos montantes de incentivos concedidos e das aplicações em pesquisa e desenvolvimento - P&D efetuadas, com observância dos sigilos comercial, fiscal e financeiro. ([Parágrafo único com redação dada pelo Decreto nº 8.247, de 23/5/2014](#))

Art. 21. Sem prejuízo do disposto no art. 9º, a Secretaria da Receita Federal do Brasil estabelecerá, em ato próprio, a necessidade de apresentação, em prazo definido, de declarações periódicas que demonstrem as relações insumo-produto dos bens beneficiados pelo PADIS, para fins de acompanhamento e controle.

CAPÍTULO VI DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 22. O disposto neste Decreto não afasta a competência dos órgãos anuentes, no que se refere à liberação e ao controle dos bens listados nos Anexos.

Art. 22-A. Os Anexos II a IV poderão ser alterados por Portaria Interministerial dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da Fazenda. ([Artigo acrescido pelo Decreto nº 8.247, de 23/5/2014](#))

Art. 23. As disposições dos incisos I a III do *caput* do art. 2º e dos incisos I e II do *caput* do art. 4º vigorarão até 22 de janeiro de 2022. ([Artigo com redação dada pelo Decreto nº 7.600, de 7/11/2011](#))

Art. 23-A. As disposições do inciso IV do *caput* do art. 2º vigorarão:

I - até 22 de janeiro de 2022, no caso dos projetos que alcancem as atividades referidas nas alíneas:

a) "a" ou "b" do inciso I do *caput* do art. 6º; ou

b) "a" ou "b" do inciso II do *caput* do art. 6º;

II - até 31 de dezembro de 2020, no caso dos projetos que alcancem somente as atividades referidas na alínea "c" do inciso I do *caput* do art. 6º; ou na alínea "c" do inciso II do *caput* do art. 6º. ([Artigo com redação dada pelo Decreto nº 7.600, de 7/11/2011](#))

Art. 24. As disposições do art. 3º e do inciso III do art. 4º vigorarão por:

I - dezesseis anos, contados da data de aprovação do projeto, no caso dos projetos que alcancem as atividades referidas nas alíneas:

a) "a" ou "b" do inciso I do art. 6º; ou

b) "a" ou "b" do inciso II do art. 6º;

II - doze anos, contados da data de aprovação do projeto, no caso dos projetos que alcancem somente as atividades referidas na alínea:

a) "c" do inciso I do art. 6º; ou

b) "c" do inciso II do *caput* do art. 6º; e [*\(Alínea com redação dada pelo Decreto nº 8.247, de 23/5/2014\)*](#)

III - quatorze anos, contados da data de aprovação do projeto, no caso dos projetos que cumpram o Processo Produtivo Básico referido no inciso III do *caput* do art. 6º. [*\(Inciso acrescido pelo Decreto nº 8.247, de 23/5/2014\)*](#)

Art. 25. A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará, no âmbito de sua competência, a aplicação das disposições deste Decreto, inclusive em relação aos procedimentos para a habilitação.

Art. 26. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 11 de outubro de 2007; 186º da Independência e 119º da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Guido Mantega

Miguel Jorge

Sergio Machado Rezende

ANEXO I

[*\(Anexo com redação dada pelo Anexo I do Decreto nº 8.247, de 23/5/2014\)*](#)

Produtos Finais

Dispositivos eletrônicos semicondutores	NCM
Diodos, transistores e dispositivos semelhantes semicondutores; dispositivos fotossensíveis semicondutores, incluídas as células fotovoltaicas, mesmo montadas em módulos ou em painéis; diodos emissores de luz; cristais piezelétricos montados	85.41
Circuitos integrados eletrônicos	85.42
Dispositivos de armazenamento não volátil de dados à base de semicondutores da posição 85.42, montados pelo processo chip on board	8523.51
Mostradores de Informação	NCM
Dispositivos de plasma	85.29
Displays construídos a partir de OLED da posição 85.41	---
Displays construídos a partir de TFEL das posições 85.41 e 85.42	---
Displays de cristal líquido (LCD)	85.29
Dispositivos de cristais líquidos (LCD)	9013.80.10
Insumos e equipamentos considerados estratégicos para a indústria de semicondutores e displays , com observância de cumprimento de Processo Produtivo Básico	NCM
Silício	2804.6
Lâminas de silício (wafer)	3818.00.10

Lâminas de outros materiais semicondutores (wafer)	3818.00.90
Fotomáscaras sobre vidro plano, positivas, próprias para gravação em pastilhas de silício (chips) para fabricação de microestruturas eletrônicas	3705.90.10
Outras fotomáscaras sobre vidro ou quartzo, próprias para gravação em pastilhas de silício ou outros materiais para fabricação de micro e nanoestruturas eletrônicas	3705.90.90
Vidro óptico, flotado, em chapas ou em folhas, com ou sem camada de material condutivo transparente, para a fabricação de displays de LCD, LED ou plasma e outros dispositivos mostradores, com espessura inferior a 1cm	70.05
Vidro óptico, flotado, em chapas ou em folhas, trabalhado, com camada de material condutivo transparente, para a fabricação de displays de LCD, LED ou plasma e outros dispositivos mostradores, com espessura inferior a 1cm	70.06
Filmes ou películas, com propriedades ópticas, compostos por camadas de materiais inorgânicos e de polímeros, com tratamento condutivo transparente, para a fabricação de displays de LCD, LED ou plasma e outros dispositivos mostradores	3920.10.99

ANEXO II

[*\(Anexo com redação dada pelo Anexo II do Decreto nº 8.247, de 23/5/2014\)*](#)

Máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, a serem incorporados ao ativo imobilizado, para emprego nas atividades vinculadas aos produtos finais

Descrição	NCM
Tintas e vernizes, à base de polímeros sintéticos ou de polímeros naturais modificados, dispersos ou dissolvidos em meio não aquoso	32.08
Colas e outros adesivos preparados, não especificados nem compreendidos noutras posições; produtos de qualquer espécie utilizados como colas ou adesivos, acondicionados para venda a retalho como colas ou adesivos, com peso líquido não superior a 1kg	35.06
Tanques em plástico	39.25
Revestimentos para pisos (pavimentos) de borracha não alveolar	4016.91
Juntas, gaxetas e semelhantes, de borracha não alveolar	4016.93
Mangueiras e tubos semelhantes, de matérias têxteis, mesmo com reforço ou acessórios de outras matérias	59.09
Lãs minerais	6806.10
Tubos e perfis ocios, sem costura, de ferro ou aço	73.04
Portas e janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras, de ferro fundido, ferro ou aço, exceto as construções pré-fabricadas da posição 94.06	7308.30
Tanques em aço inoxidável, com capacidade superior a 300litros	7309.00
Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro fundido, ferro ou aço, de capacidade não superior a 300l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	73.10
Tanques para estocagem de gases	73.11

Descrição	NCM
Construções e suas partes (por exemplo, pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilones, pilares, colunas, armações, estruturas para telhados, portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras, balaustradas), de alumínio, exceto as construções pré-fabricadas da posição 94.06; chapas, barras, perfis, tubos e semelhantes, de alumínio, próprios para construções	76.10
Ferramentas de embutir, de estampar ou de puncionar	8207.30.00
Caldeiras para aquecimento central, exceto as da posição 84.02	84.03
Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor	84.13
Partes de bombas	8413.91
Bombas de vácuo	8414.10.00
Bombas de ar ou de vácuo, compressores de ar ou de outros gases e ventiladores; coifas aspirantes para extração ou reciclagem, com ventilador incorporado, mesmo filtrantes	84.14
Partes de bombas de vácuo e compressores	8414.90
Unidades funcionais destinadas ao condicionamento e refrigeração do ar de “salas limpas”	84.15
Fornos laboratoriais elétricos	84.17
Refrigeradores, congeladores (freezers) e outros materiais, máquinas e aparelhos para a produção de frio, com equipamento elétrico ou outro; bombas de calor	84.18
Partes de máquinas e aparelhos da posição 8418	8418.9
Secadores; exceto para produtos agrícolas, madeiras, pastas de papel, papéis ou cartões	8419.39
Aparelhos de destilação	8419.40
Trocadores de calor	8419.50
Estufas elétricas	8419.89.20
Placas de aquecimento	84.19
Evaporadores	8419.89.40
Partes de destiladores, trocadores de calor, estufas e evaporadores	8419.90
Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos; aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases	84.21
Partes de aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases	8421.9
Máquinas e aparelhos para empacotar ou embalar circuitos integrados	8422.40.90
Aparelhos e instrumentos de pesagem, de capacidade não superior a 30kg	8423.81
Máquinas para aplicação e remoção de polarizador	84.24
Máquinas de jateamento para formação de estruturas em substratos inorgânicos	84.24
Aparelhos mecânicos (mesmo manuais) para projetar, dispersar ou pulverizar líquidos ou pós	8424.89.90
Máquinas e aparelhos de elevação, de carga, de descarga ou de movimentação suscetíveis de serem utilizadas para a coleta ou manipulação de dispositivos semicondutores e mostradores de informação (displays)	84.28
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas e aparelhos das posições 84.28, utilizadas na fabricação de componentes semicondutores e circuitos integrados	8431.39
Máquinas e aparelhos de impressão por meio de blocos, cilindros e outros elementos de impressão da posição 84.42 e outras impressoras destinadas à identificação e marcação de componentes eletrônicos semicondutores e circuitos integrados	8443.19
Impressoras, aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax), mesmo combinados entre si; exceto as máquinas e aparelhos de impressão por meio de blocos, cilindros e outros elementos de impressão da posição 84.42	8443.3

Descrição	NCM
Máquinas que executem pelo menos duas das seguintes funções: impressão, cópia ou transmissão de telecópia (fax), capazes de ser conectadas a uma máquina automática para processamento de dados ou a uma rede	8443.31
Partes e acessórios das máquinas e aparelhos de impressão da posição 8443.19	8443.9
Máquinas-ferramentas que trabalhem por eliminação de qualquer matéria	84.56
Máquinas-ferramentas suscetíveis de serem utilizadas na fabricação de dispositivos semicondutores e mostradores de informação (displays)	84.60
Máquinas-ferramentas e prensas, suscetíveis de serem utilizadas na fabricação de dispositivos semicondutores e mostradores de informação (displays)	84.62
Máquinas-ferramentas para trabalhar produtos cerâmicos ou matérias minerais semelhantes, ou para o trabalho a frio do vidro, suscetíveis de serem utilizadas na fabricação de dispositivos semicondutores e mostradores de informação (displays)	84.64
Máquinas automáticas para processamento de dados apresentadas sob a forma de sistemas	8471.49
Unidades de entrada ou de saída de máquinas automáticas para processamento de dados, podendo conter, no mesmo corpo, unidades de memória	8471.60
Unidades de memória de máquinas automáticas para processamento de dados	8471.70
Leitores de código de barras	8471.90.12
Partes e acessórios das máquinas da posição 8471	8473.30
Máquinas para fabricação ou trabalho a quente do vidro ou das suas obras	8475.2
Máquinas para laminação de polímeros	84.77
Máquinas de moldar por injeção	8477.10
Extrusoras	8477.20
Máquinas de moldar por insuflação	8477.30
Máquinas de moldar a vácuo e outras máquinas de termoformar	8477.40
Máquinas de estampagem para gravação de estruturas em materiais orgânicos	84.79
Robôs industriais	8479.50.00
Máquinas para posicionar componentes elétricos e/ou eletrônicos	84.79
Agitadores	8479.82.10
Máquinas e aparelhos mecânicos com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições do Capítulo 84, suscetíveis de serem utilizados na fabricação de dispositivos semicondutores e mostradores de informação (displays)	84.79
Equipamentos para limpeza por ultrassom	8479.89.91
Caixas-de-luvas (glove box)	84.79
Máquinas e equipamentos para estampagem (silk screen)	84.42
Partes de máquinas e equipamentos para estampagem (silk screen)	8442.40
Válvulas	84.81
Partes de válvulas	8481.90
Juntas	84.84
Máquinas e aparelhos dos tipos utilizados exclusiva ou principalmente na fabricação de esferas (boules) ou de plaquetas (wafers) de dispositivos semicondutores para a fabricação de circuitos integrados eletrônicos ou de dispositivos de visualização de tela plana	84.86
Máquinas e aparelhos especificados na Nota 9C do Capítulo 84 da NCM; Partes e acessórios	84.86
Partes e acessórios	8486.90.00

Descrição	NCM
Motores elétricos	85.01
Grupos eletrogêneos e conversores rotativos elétricos	85.02
Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos, bobinas de reatância e de autoindução	85.04
Fornos elétricos industriais ou de laboratório, incluídos os incineradores, não elétricos	85.14
Máquinas e aparelhos suscetíveis de serem utilizadas na fabricação de dispositivos semicondutores e mostradores de informação (displays) e suas partes, peças e acessórios	85.15
Roteadores	8517.62.
Microfone	8518.10.90
Alto falantes	8518.22.00
Discos, fitas, dispositivos de armazenamento de dados, não volátil, à base de semicondutores, “cartões inteligentes” e outros suportes para gravação de som ou para gravações semelhantes, mesmo gravados, incluindo as matrizes e moldes galvânicos para fabricação de discos, exceto os produtos do Capítulo 37	85.23
Câmera CFTV	8525.80.29
Monitores policromáticos dos tipos exclusiva ou principalmente utilizados num sistema automático para processamento de dados da posição 84.71	8528.51.20
Outros monitores policromáticos	8528.59.20
Aparelhos elétricos de sinalização acústica ou visual (por exemplo, campainhas, sirenes, quadros indicadores, aparelhos de alarme para proteção contra roubo ou incêndio), exceto os das posições 85.12 ou 85.30	85.31
Aparelhos para interrupção, seccionamento, proteção, derivação, ligação ou conexão de circuitos elétricos (por exemplo, interruptores, comutadores, relés, corta-circuitos, eliminadores de onda, plugues e tomadas de corrente, suportes para lâmpadas e outros conectores, caixas de junção), para uma tensão não superior a 1.000V; conectores para fibras ópticas, feixes ou cabos de fibras ópticas	85.36
Quadros, painéis, consoles, cabines, armários e outros suportes com dois ou mais aparelhos das posições 8535 ou 8536, para comando elétrico ou distribuição de energia (incluídos os que incorporem instrumentos ou aparelhos do Capítulo 90 da NCM, adequados para tensão não superior a 1.000 Volts	85.37
Controladores programáveis	8537.10.20
Lâmpadas e tubos elétricos de incandescência ou de descarga, incluindo os artigos denominados “faróis e projetores, em unidades seladas” e as lâmpadas e tubos de raios ultravioleta ou infravermelhos; lâmpadas de arco, e suas partes	85.39
Lentes, prismas, espelhos e outros elementos de óptica, de qualquer matéria, montados, para instrumentos ou aparelhos, exceto os de vidro não trabalhado opticamente	90.02
Circuitos integrados eletrônicos	85.42
Condutores elétricos, para uma tensão não superior a 1.000V	8544.4
Condutores elétricos, para uma tensão superior a 1.000V	8544.60
Cabos de fibras ópticas	8544.70
Microscópios óticos	90.11
Partes e acessórios de microscópios óticos	9011.90
Microscópios eletrônicos	90.12
Partes e acessórios de microscópios eletrônicos	9012.90
Dispositivos de cristais líquidos que não constituam artigos compreendidos mais especificamente noutras posições; lasers, exceto diodos laser; outros aparelhos e instrumentos de óptica, não	90.13

Descrição	NCM
especificados nem compreendidos noutras posições do presente Capítulo	
Instrumentos e aparelhos de geodésia, topografia, agrimensura, nivelamento, fotogrametria, hidrografia, oceanografia, hidrologia, meteorologia ou de geofísica, exceto bússolas; telêmetros	90.15
Balanças sensíveis a pesos iguais ou inferiores a 5cg, com ou sem pesos	9016.00
Instrumentos de desenho, de traçado ou de cálculo (por exemplo, máquinas de desenhar, pantógrafos, transferidores, estojos de desenho, réguas de cálculo e discos de cálculo); instrumentos de medida de distâncias de uso manual (por exemplo, metros, micrômetros, paquímetros e calibres), não especificados nem compreendidos noutras posições do presente Capítulo	90.17
Aparelhos de raios x e aparelhos que utilizem radiações alfa, beta ou gama, mesmo para usos médicos, cirúrgicos, odontológicos ou veterinários, incluindo os aparelhos de radiofotografia ou de radioterapia, os tubos de raios x e outros dispositivos geradores de raios x, os geradores de tensão, as mesas de comando, as telas de visualização, as mesas, poltronas e suportes semelhantes para exame ou tratamento	90.22
Instrumentos, aparelhos e modelos, concebidos para demonstração (por exemplo, no ensino e nas exposições), não suscetíveis de outros usos	90.23
Máquinas e aparelhos para ensaios de dureza, tração, compressão, elasticidade ou de outras propriedades mecânicas de materiais (por exemplo, metais, madeira, têxteis, papel, plásticos), utilizadas na fabricação de dispositivos semicondutores e mostradores de informação (displays)	90.24
Densímetros, areômetros, pesa-líquidos e instrumentos flutuantes semelhantes, termômetros, pirômetros, barômetros, higrômetros e psicrômetros, registradores ou não, mesmo combinados entre si	90.25
Instrumentos e aparelhos para medida ou controle da vazão, do nível, da pressão ou de outras características variáveis dos líquidos ou gases	90.26
Instrumentos e aparelhos para análises físicas ou químicas (por exemplo, polarímetros, refratômetros, espectrômetros, analisadores de gases ou de fumaça)	90.27
Contadores de gases, de líquidos ou de eletricidade, incluindo os aparelhos para sua aferição	90.28
Estroboscópios	9029.20.20
Osciloscópios, analisadores de espectro e outros instrumentos e aparelhos para medida ou controle de grandezas elétricas	90.30
Instrumentos, máquinas e aparelhos de medida ou controle de discos (wafers) ou de dispositivos semicondutores ou ainda para controle de máscaras ou retículas utilizadas na fabricação de dispositivos semicondutores	9031.41
Conjunto para “teste de vazamento a hélio”	9031.80.99
Placas com soquetes especiais para burn in e aging	9031.90.90
Instrumentos e aparelhos automáticos para regulação ou controle - termostatos	9032.10
Reguladores de voltagem	9032.89.1
Outros instrumentos e aparelhos automáticos para regulação ou controle de grandezas não elétricas - de pressão	9032.89.81
Outros instrumentos e aparelhos automáticos para regulação ou controle de grandezas não elétricas - de temperatura	9032.89.82
Outros instrumentos e aparelhos automáticos para regulação ou controle de grandezas não elétricas - de umidade	9032.89.83
Outros instrumentos e aparelhos automáticos para regulação ou controle de grandezas não elétricas	9032.89.89
Outros instrumentos e aparelhos automáticos para regulação ou controle	9032.89.90

Descrição	NCM
Partes e acessórios para instrumentos e aparelhos da posição 90.32	9032.90
Aparelhos elétricos de iluminação, de alumínio	9405.40.90

ANEXO III

[*\(Anexo com redação dada pelo Anexo III do Decreto nº 8.247, de 23/5/2014\)*](#)

Insumos para emprego nas atividades vinculadas aos produtos finais

Descrição	NCM
Gás natural	2711.21.00
Coque de petróleo não calcinado	2713.11.00
Cloro	2801.10.00
Hidrogênio	2804.10.00
Hélio	2804.29
Argônio	2804.21.00
Nitrogênio	2804.30.00
Oxigênio	2804.40.00
Silício, não dopado	2804.61.00
Silício metalúrgico de grau solar	2804.69.00
Fósforo	2804.70
Ácido clorídrico	2806.10
Ácido sulfúrico	2807.00
Ácido nítrico	2808.00.10
Ácido fosfórico	2809.20.1
Ácido fluorídrico	2811.11.00
Brometo de hidrogênio	2811.19.90
Dióxido de carbono (CO ₂)	2811.21.00
Hidróxido de potássio (potassa cáustica)	2815.20.00
Hidroxilamina	2825.10.20
Brometo de hidrogênio	2811.19.90
Óxido nitroso	2811.29.90
Tricloreto de boro	2812.10.19
Tetracloreto de silício	2812.10.19
Tetracloreto de estanho	2812.10.19
Oxicloreto de fósforo	2812.10.22
Trifluoreto de nitrogênio	2812.90.00
Hexafluoreto de enxofre	2812.90.00
Dióxido de carbono	2811.21.00
Trifluoreto de boro	2812.90.00
Tribrometo de boro	2812.90.00
Amoníaco (gás amoníaco)	2814.10.00
Hidróxido de amônia	2814.20.00
Hidróxido de Sódio, em solução aquosa	2815.12.00

Descrição	NCM
Hidróxido de potássio (potassa cáustica)	2815.20.00
Alumina calcinada	2818.20.10
Trióxido de cromo	2819.10.00
Trióxido de antimônio	2825.80.10
Fluoreto de amônia	2826.19.90
Hexafluoreto de tungstênio (volfrâmio)	2826.19.90
Fluoreto de criptônio	2826.19.90
Fluoreto argônio	2826.19.90
Hexafluoreto de tungstênio	2826.90.90
Iodato de potássio	2829.90.31
Sulfeto de germânio	2830.90.19
Tiosulfato de sódio	2832.30.20
Sulfatos de sódio	2833.1
Sulfato de alumínio	2833.22.00
Sulfato de cobre cuproso	2833.25.10
Nitrato férrico	2834.29.90
Volframato de titânio	2841.80.90
Soluções de metais preciosos, apresentadas em estado coloidal	2843.10.00
Peróxido de hidrogênio	2847.00.00
Fosfina (fosfeto de hidrogênio ou hidreto de fósforo)	2848.00.90
Carboneto de silício	2849.20.00
Carbonetos de tungstênio (volfrâmio)	2849.90.30
Arsina	2850.00.90
Diborano	2850.00.90
Diclorometano (cloreto de metileno)	2903.12.00
Álcool isopropílico	2905.12.20
Trimetilfosfita (metilfosfonato de dimetila)	2931.90.79
Trimelborato (metilborato de dimetila)	2931.90.90
Trietilfosfato (metilfosfato de dimetila)	2931.90.79
Tetracloroeto de Carbono	2903.14.00
Tetrafluoreto de Carbono	2903.39.19
Fluoreto Metílico	2903.39.19
Fluoreto de metila	2903.39.19
Hexafluoretano	2903.39.19
Fluormetano	2903.39.19
Trifluormetano	2903.39.19
Trifluoroetano	2903.39.19
Tetrafluorometano	2903.39.19
Difluorometano	2903.39.19
Triclorofluormetano	2903.41.00
Octafluorociclobutano	2903.59.90
Álcoois acíclicos e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados	29.05

Descrição	NCM
Etilenoglicol	2905.31.00
Metanol	2905.11.00
Álcool isopropílico	2905.12.20
Álcool n-butílico	2905.13.00
Metoxitanol (éter monoetílico de etilenoglicol)	2909.49.29
Acetona	2914.11.00
Ácido acético	2915.21.00
Acetato butílico (acetato de n-butila)	2915.33.00
Ácido oxálico di-hidratado	2917.11.10
Monoetanolamina	2922.11.00
Trietanolamina	2922.13.10
Hidróxido de tetrametilamônio	2923.90.90
Dimetilacetamida	2924.29.49
Silano	2931.00.29
Diclorosilano	2931.00.29
Tetrametilsilano	2931.00.29
Tetrametilciclotetrasiloxano	2931.00.29
Hexametildisilano	2931.00.29
Tetraetilortosilicato	2931.00.29
Trimetilfosfato	2931.00.39
Isopropóxido de estanho	2931.00.49
Lactato de alumínio	2931.00.69
Isopropóxido de titânio	2931.00.90
Trimetilborato	2931.00.90
Tetrakis Dimetilamino Titânio	2931.90.90
N-Metil-2-Pirrolidona	2933.79.90
Benzotriazol	2933.99.99
Fritas de vidro	3207.40.10
Tintas e vernizes, à base de polímeros sintéticos ou de polímeros naturais modificados, dispersos ou dissolvidos em meio não aquoso; soluções definidas na Nota 4 do Capítulo 32 do Sistema Harmonizado	32.08
Tintas e vernizes, à base de polímeros sintéticos ou de polímeros naturais modificados, dispersos ou dissolvidos num meio aquoso	32.09
Colas e outros adesivos preparados, não especificados nem compreendidos noutras posições do Sistema Harmonizado; produtos de qualquer espécie utilizados como colas ou adesivos, acondicionados para venda a retalho como colas ou adesivos, com peso líquido não superior a 1kg	35.06
Fotomáscaras sobre vidro plano, positivas, próprias para gravação em pastilhas de silício (chips) para fabricação de microestruturas eletrônicas	3705.90.10
Outras fotomáscaras sobre vidro ou quartzo, próprias para gravação em pastilhas de silício ou outros materiais para fabricação de micro e nanoestruturas eletrônicas	3705.90.90
Preparações para decapagem de metais	3810.10.10
Pastas e pós para soldar	3810.10.20

Descrição	NCM
Fluxos para soldar	3810.90.00
Preparações para enchimento ou revestimento de eletrodos ou de varetas para soldar	3810.90.00
Solventes e diluentes orgânicos, não especificados nem compreendidos em outras posições	3814.00.00
Preparações concebidas para remover tintas ou vernizes	3814.00.00
Iniciadores de reação, aceleradores de reação e preparações catalíticas, não compreendidos em outras posições do Sistema Harmonizado	38.15
Lâminas de silício monocristalino do tipo p, dopadas com boro (B), com ou sem camada epitaxial, orientação cristalina de <111> ou <100>	3818.00.10
Lâminas de silício monocristalino, dopadas com fósforo, arsênio ou antimônio, com ou sem camada epitaxial, orientação cristalina de <111> ou <100>	3818.00.10
Preparação isolante dielétrica, à base de sílica	3824.90.72
Solução tamponada de fluoreto de amônio e ácido fluorídrico (BOE)	3824.90.79
Mistura Solvente composta por 70% de butirolactona (BGL) e 30% de álcool n-butílico (NBA)	3824.90.89
Susbttrato de quartzo, na forma de bolachas	3818.00.90
Susbstratos para dispositivos fotônicos, na forma de bolachas	3818.00.90
Mistura de fosfina e nitrogênio	3824.90.79
Mistura de arsina e hidrogênio	3824.90.79
Mistura de hidrogênio e nitrogênio	3824.90.79
Mistura de oxigênio e hélio	3824.90.79
Mistura de diborano com nitrogênio	3824.90.79
Mistura de fosfina e silano	3824.90.79
Mistura de fluoreto de amônia e ácido fosfórico, em água	3824.90.79
Revelador de fotoresiste	3824.90.79
Removedor de óxidos, tamponado, constituído por mistura de fluoreto de amônia, ácido fluorídrico e água	3824.90.79
Materiais nanoestruturados a base de compostos inorgânicos	3824.90.79
Mistura de fluoreto de amônia e ácido fosfórico, em água	3824.90.79
Mistura de tetrafluorometano em oxigênio	3824.90.89
Mistura de monoetanolamina, hidroxilamina e pirocatecol, em água	3824.90.89
“Fotoresiste orgânico” (solução de polímero ou resina epóxi em solvente orgânico)	3824.90.89
Mistura de ácido fosfórico, ácido nítrico e ácido acético, sem surfactante	3824.90.89
Mistura de ácido fosfórico, ácido nítrico e ácido acético, com surfactante	3824.89.90
Materiais nanoestruturados em carbono	3824.90.89
Cristais líquidos, incluindo os termotrópicos e os liotrópicos	3824.90.89
Materiais nanoestruturados a base de compostos orgânicos	3824.90.89
Compostos químicos para aprisionamento de gases residuais (getters)	3824.90
Polímeros de etileno, em formas primárias	39.01
Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias	39.02
Poli (metilmetacrilato) (PMMA)	3906.10.00
Poli(ácido acrílico)	3906.90.31
Polímeros, do tipo “poliéteres perfluorados”, utilizados como óleos para bombas de vácuo	3907.20.90
Resina epóxi	3907.30

Descrição	NCM
Poli (dimetilglutarimida) (PMGI)	3911.90.29
Poliimidas	3911.90.29
Tubos e acessórios, de plástico	39.17
Chapas, folhas, tiras, fitas, películas e outras formas planas, auto-adesivas, de plásticos, mesmo em rolos com largura superior a 20 centímetros	3919.90.00
Recipientes plásticos, dos tipos utilizados no transporte de chips	3923.90
Placas plásticas recobertas com filmes transparentes e condutores de energia	39.26
Anéis de seção transversal circular (O rings)	3926.90.6
Luvras, mitenes e semelhantes, de malha	61.16
Sobretudos, juponas, gabões, capas, anoraques, casacos e semelhantes, de uso masculino, de fibras sintéticas ou artificiais, exceto os artefatos da posição 62.03	62.01
Mantôs, capas, anoraques, casacos e semelhantes, de uso feminino, de fibras sintéticas ou artificiais, exceto os artefatos da posição 62.04	62.02
Ternos, conjuntos, paletós, calças e jardineiras, de uso masculino, de fibras sintéticas ou artificiais	62.03
Conjuntos, blazers , vestidos, saias, saias-calças, calças e jardineiras, de uso feminino, de fibras sintéticas ou artificiais	62.04
Luvras, mitenes e semelhantes	6216.00.00
Chapéus, toucas e outros artefatos de uso semelhante, de fibras sintéticas ou artificiais	6505.90.12
Produtos cerâmicos refratários elaborados de grafita	69.03
Tubos de quartzo, não trabalhados	7002.31.00
Ampolas para lâmpadas	70.11
Vidraria para laboratórios	70.17
Pastilhas de vidro	7020.00
Tubos de quartzo, trabalhados	7020.00.90
Janelas de safira	7103.91.00
Janelas de diamante	7104.20.10
Materiais sintéticos ou reconstituídos, com propriedades piezoelétricas, apresentados na forma de placas ou lâminas	7104.20.90
Pó de diamante para polimento de superfícies	71.05
Ouro, incluído o ouro platinado, apresentado em pó, em formas brutas ou semimanufaturadas	71.08
Fio de ouro	7108.13.10
Platina em pó, em formas brutas ou semimanufaturadas	7110.1
Paládio em pó, em formas brutas ou semimanufaturadas	7110.2
Tubos em aço inoxidável	73.04
Acessórios para tubos em aço inoxidável	73.07
Anodo de cobre, fosforizado	7402.00.00
Cobre refinado e ligas de cobre em formas brutas	74.03
Ligas de cobre para solda	74.05
Ligas de níquel para solda, na forma de barras, perfis ou fios	75.05
Pós e escamas, de cobre	74.06
Pós e escamas de níquel, ligados ou não ligados	7504.00
Fios de níquel, ligados ou não ligados	7505.2

Descrição	NCM
Tubos feitos em ligas de níquel	7507.12.00
Placas de alumínio ligado com silício, com cobre ou com silício e cobre, para utilização em equipamento de deposição por bombardeamento catódico	7606.12
Outras obras de alumínio	76.16
Zinco não ligado	7901.1
Esferas de estanho dos tipos utilizados na fabricação de circuitos integrados e dispositivos semicondutores	8007.00.90
Tungstênio (volfrâmio) e suas obras, incluídos os desperdícios e resíduos	81.01
Molibdênio e suas obras, incluídos os desperdícios e resíduos	81.02
Obras de tântalo	8103.90.00
Magnésio e suas obras, incluindo os desperdícios e resíduos.	81.04
Chapas, folhas, tiras, fios, hastes, pastilhas e plaquetas; de cobalto	8105.90.10
Titânio e suas obras, incluídos os desperdícios e resíduos	81.08
Placas de titânio para utilização em equipamento de deposição por bombardeamento catódico	8108.90.00
Liga de níquel, ferro e cobalto, do tipo “Kovar”, na forma fios, varetas, placas ou tarugos	83.11
Janelas de berílio	8112.19.00
Cromo	8112.2
Nióbio e suas obras, incluídos os desperdícios e resíduos	8112.9
Ceramais (cermets) e suas obras, incluindo os desperdícios e resíduos	8113.00
Discos de serra	8208.90.00
Fios, varetas, tubos, chapas, eletrodos e artefatos semelhantes, de metais comuns ou de carbonetos metálicos, revestidos interior ou exteriormente de decapantes ou de fundentes, para soldadura ou depósito de metal ou de carbonetos metálicos; fios e varetas, de pós de metais comuns aglomerados, para metalização por projeção	83.11
Partes empregadas em displays	85.29
Condensadores elétricos, fixos	8532.2
Resistências fixas de carbono, aglomeradas ou de camada	8533.10.00
Outras resistências fixas	8533.2
Circuitos impressos	85.34
Conectores para displays	85.36
Capas estampadas para componentes eletrônicos	8541.90.90
Capas cerâmicas para componenets eletrônicos	8541.90.90
Tampa superior de capas para componentes eletrônicos	8541.90.90
Circuitos integrados de acionamento para displays	85.42
Circuitos integrados, não montados, sob a forma de discos (wafers) ainda não cortados em microplaquetas (chips)	8542.31
	8542.32
	8542.33
	8542.39
Partes de circuitos integrados eletrônicos	8542.90
Placas de nitreto de titânio para utilização em equipamento de deposição por bombardeamento catódico	8543.90.90
Microespaçadores de materiais dielétricos, orgânicos ou inorgânicos, para separação das	85.46

Descrição	NCM
placas de vidro de displays	
Máscaras ou retículos, em vidro ou quartzo, para fotografação, com impressão em filme metálico ou composto para uso em alinhadoras por contato, projeção ou de repetição	9002.90.00

ANEXO IV

(Anexo com redação dada pelo Anexo IV do Decreto nº 8.247, de 23/5/2014)

Ferramentas computacionais para emprego nas atividades vinculadas aos produtos finais

Descrição	NCM
Programas de computador, do tipo EDA (Electronic Design Automation) ou semelhante, para a realização de projeto de circuitos integrados e que fazem parte das ferramentas de CAE/CAD/CAM	---
Programas de computador, do tipo “IP cores” ou semelhante, contendo elementos de projeto pré-programados e testados, que desempenham funções específicas, utilizados no projeto de circuitos integrados	---
Simuladores de processo, do tipos ISE/TCAD, Suprem ou semelhantes, para executarem simulações das etapas de processamento físico-químico, utilizados no processo de produção e/ou de gestão da produção de circuitos integrados	---
Simuladores de fotolitografia, do tipo “Prolith” ou semelhante, utilizados no processo de produção e/ou de gestão da produção de circuitos integrados	---
Programas para extração de parâmetros elétricos e modelamento, utilizados no processo de produção e/ou de gestão da produção de circuitos integrados	---
Programas para medidas elétricas, utilizados exclusiva e especificamente no processo de produção e de gestão da produção de circuitos integrados	---
Programas para análise e interpretação de defeitos, utilizados exclusiva e especificamente no processo de produção e de gestão da produção de circuitos integrados	---
Programas para automação de fábrica, utilizados exclusiva e especificamente no processo de produção e de gestão da produção de circuitos integrados	---
Programas para otimização de rendimento, utilizados exclusiva e especificamente no processo de produção e de gestão da produção de circuitos integrados	---